

图书基本信息

书名：<<Pro/ENGINEER手机结构设计手册>>

13位ISBN编号：9787115156914

10位ISBN编号：7115156913

出版时间：2007-3

出版时间：人民邮电

作者：潘光泉

页数：421

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

《Pro/ENGINEER手机结构设计手册》第1篇设计入门篇包括前两章。

第1章主要介绍手机设计流程，内容包括各个阶段的工作内容及大致时间安排；第2章介绍手机种类及其基本结构，将市场上主要的3种类型手机的结构进行了大致讲解。

第2篇加工工艺篇为第3章。

第3章介绍手机外观部件的加工工艺，主要包括喷涂、电镀、IMD及其他一些常用工艺。

第3篇电子元器件篇包括第4章至第6章。

第4篇主要介绍了手机主板设计和工艺及电子元器件的布局和工艺知识，另外还介绍了与主板相关的部件的基本知识及相关结构设计；第5章首先介绍了塑料件及钣金件的通用结构设计知识，然后介绍了手机塑料件的相关结构设计；第6章非常详尽地介绍了手机按键的种类、加工工艺及相关结构设计。

第4篇主体结构篇包括第7章至第11章。

第7章主要介绍了手机LCD及LCD面板的相关知识及结构设计，另外还介绍了导光柱及触摸屏的相关知识；第8章介绍了手机常用金属装饰件的基本工艺及结构设计；第9章简单介绍了模切相关知识；第10章介绍了摄像头及自拍镜的相关知识；第11章介绍了一些塞子的设计及弹簧的设计计算。

第5篇附件篇包括第12章至第13章。

第12章详尽介绍了手机转轴的分类及相关结构设计；第13章介绍EMI及ESD的相关知识，这部分的知识对于手机结构设计人员相当重要。

第6篇Pro/E应用篇即第14章。

这一章主要介绍了如何使用Pro/E软件进行结构设计。

书籍目录

第1篇 设计入门篇第1章 手机设计流程1.1 手机设计流程及时间安排1.2 手机设计流程解析第2章 手机的基本结构2.1 直板手机的一般结构2.2 折叠手机的一般结构2.3 滑盖手机的一般结构第2篇 加工工艺篇第3章 手机外观加工工艺3.1 喷涂工艺3.1.1 涂料的构成及种类3.1.2 喷涂工艺流程3.1.3 UV工艺介绍3.1.4 EMI喷涂3.2 电镀工艺3.2.1 电镀的定义和分类3.2.2 常见电镀效果介绍3.2.3 电镀件设计的基本要求3.3 模内装饰IMD工艺3.4 其他表面处理工艺第3篇 电子元器件篇第4章 手机主板及其他电子部件设计4.1 Outlook及Outline的确定4.2 PCB的结构设计4.2.1 PCB的基本概念4.2.2 PCB布线4.2.3 PCB布局设计4.2.4 PCB基板Outline的确定4.2.5 主要功能模块及接口4.2.6 SMT工艺介绍4.3 相关部件设计4.3.1 屏蔽罩设计4.3.2 FPC设计4.3.3 连接器及I/O接口设计4.4 其他电子部件的设计4.4.1 喇叭和听筒的设计4.4.2 Motor或振子的设计4.4.3 麦克风结构设计4.4.4 Sim Holder设计4.5 天线设计4.5.1 无线移动通信天线4.5.2 手机天线设计4.6 电池 (Battery) 设计第5章 摄像头 (CAMERA) 及自拍镜设计第6章 EMI及ESD设计第4篇 主体结构篇第7章 手机壳体结构设计第8章 手机按键及DOME设计第9章 LCD及LCD Panel结构设计第10章 装饰件结构及工艺设计第11章 转轴设计第5篇 附件篇第12章 模切产品相关知识及设计第13章 其他创附件设计第6篇 Pro/E应用篇第14章 如何使用Pro/E软件进行手机结构设计

编辑推荐

《Pro/ENGINEER手机结构设计手册》实例及样图丰富，内容详尽，不仅可供手机结构设计的初学者学习，对于已入行的结构设计工程师也是一本很好的参考书。

《Pro/ENGINEER手机结构设计手册》一本详细介绍手机结构设计及加工工艺方面知识的书籍，全书共包括6篇14章。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>